

智微科技引領高速外接存儲裝置的新紀元

因應新一代高速外接存儲裝置的發展趨勢，智微科技(4925)於去年(2017)年台北國際電腦展期間領先業界率先推出適用於 PCIe 固態硬碟 (SSD) 專用的高速橋接晶片 JMS583 (USB 3.1 Gen2 to PCIe/NVMe) 的原型設計，並展示其優越的資料存儲效能，並已於今 (2018) 年四月正式導入量產，預期將引領外接式存儲裝置進入超高速傳輸的新紀元。

外接式存儲裝置隨著傳輸介面的技術演進，於近年已由傳統機械式硬碟逐漸進入固態硬碟時代，相較於傳統機械式硬碟，固態硬碟有著更為優越的資料存取效能與輕薄省電的特性，這些特點對於可攜式外接存儲裝置來說極具吸引力；近期固態硬碟的規格也由傳統 SATA 介面轉換成更高速的 PCIe/NVMe 介面。因此，全新的外接高速橋接晶片需求孕育而生。智微科技在這次的台北國際電腦展期間，配合多家主要客戶發表以 JMS583 橋接晶片為基礎的外接式 PCIe 固態硬碟解決方案，其實際平均資料存取速度可達 1000MB/s 以上，將 USB3.1 Gen2 的理論頻寬完全實現，也預期可為外接存儲裝置帶入超高速的使用者情境。

此外，JEDEC 固態協會針對高速傳輸記憶卡介面：UFS (Universal Flash Storage)在今年也進入成熟階段，智微科技將在本次展會推出對應

的橋接控制晶片解決方案：JMS901 (USB3.1 Gen1 to UFS/UHS-I); 此晶片將可廣泛應用於需要 UFS 介面需求與轉換的高速記憶卡讀卡器或隨身碟方案，讓客戶快速導入並應用此新的存儲介面技術。

智微科技亦將於展會同步發表多個不同應用的高速橋接晶片與對應的解決方案，這些新的晶片與方案將在下半年陸續量產上市。智微科技將持續專注於高速技術的研發，並和主要客戶合作，提供市場更高速，更省電，更方便的超高速存儲控制晶片。